

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券、东证资管
会议时间	2025 年 6 月 24 日 13：30-14：30
会议地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：简要介绍一下公司主要产品情况？ 回复：公司致力于半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售，是国内少数芯片级固体和液体封装材料研发量产的专业工厂。依托公司的核心技术体系，公司形成了可覆盖传统封装领域与先进封装领域的全面产品布局。公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。 问题二：请简要介绍一下先进封装以及封装行业发展情况 回复：工艺相对复杂、封装形式、封装技术、封装产品所用材料处于行业前沿的封装形式为先进封装，目前国内先进封装主要包括 QFN/DFN、LQFP、BGA、FC、SiP、WLCSP、Bumping、MEMS、TSV、3D 等封装形式。

	近年来，随着高性能计算、人工智能和 5G 通信等技术的需求日益增长，电子产品进一步朝向小型化与多功能发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多。后摩尔时代，芯片物理性能接近极限，提高技术节点的经济效益有所放缓。半导体行业焦点从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移，WLCSP（晶圆级芯片规模封装）、FCCSP（倒装芯片级封装）、FCBGA（倒装芯片球栅阵列封装）、2.5D 封装、3D 封装、SiP（系统级封装）等先进封装技术的发展成为延续及超越摩尔定律、提升系统性能关键路径之一，先进封装技术的不断进步，对封装材料的要求也在不断提高，先进封装材料行业正迎来新的发展机遇。 问题三：衡所华威在产品体系和技术方面有何优势？ 回复：衡所华威的产品体系全面覆盖基础、高性能、先进封装多个层次，在国内外众多细分应用领域处于领先地位。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商垄断的背景下，衡所华威立足于高性能封装的同时，积极布局先进封装领域，推动高端产品的产业化。 衡所华威产品结构聚焦于高性能产品的同时，在先进封装领域不断拓展，产品终端应用涉及汽车电子、新能源、第三代半导体、工业领域、消费电子、物联网、光伏等领域，形成了较为显著的产品体系优势。 衡所华威主要以封装技术演进趋势与客户定制化需求为导向，凭借扎实的研发实力与丰富的实践经验，在产品配方与生产工艺等方面进行持续研发与技术攻关，实现从低端到高端产品全面覆盖的技术体系，可实现灵活快速的研发需求响应。 问题四：公司所处的行业地位及其变化情况 回复：自 2010 年成立以来，公司始终专注于半导体封装材料的研发及产业化，公司深耕于半导体封装材料的研发创新，核心技术以配方技术与生产工艺技术作为体系基础，可广泛应用于传统封装与先进封装领域，技术储备丰富且具有前沿性，可为客户解
--	--

	决历代下游主流封装技术的需求难点提供有力的技术支撑，公司拥有独立自主的系统化知识产权。公司紧跟下游封装行业的发展趋势，以客户需求为导向，对相关技术难点进行持续攻坚，形成适合各类封装形式的全系列产品与技术布局。在传统封装领域，公司产品结构全面并已实现产业化，市场份额逐步扩大，在国内市场已具备较高的品牌知名度及市场影响力；在先进封装领域，公司相关产品已陆续通过客户考核验证，技术水平取得业内主要封装厂商的认可，公司在加大核心技术开发的同时，注重在半导体封装材料领域的研发成果的运用，注重实现核心技术的产业化。依托公司具有市场竞争优势的核心技术体系，公司专注于向客户提供更有竞争力的环氧塑封料与电子胶黏剂产品，构建可应用于传统封装与先进封装的全面产品体系，可满足下游客户日益提升的性能需求。 问题五：本次收购完成后对公司业务方面的发展前景有何影响？ 回复：本次交易完成后，有利于公司发挥在资金、市场、经营管理方面的协同，扩大业务规模、提高经营业绩。 本次交易完成后，公司将进一步把握衡所华威的经营计划和业务方向，依据其业务特点，将衡所华威发展规划与公司发展战略深度绑定，通过资源共享和优势互补，整合研发资源、补齐产品矩阵、加速国际化布局，实现业务协同发展，控制采购成本和资金运营成本，促进生产效率、经营水平的提升。 注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 24 日